

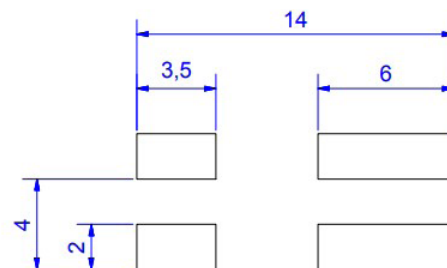
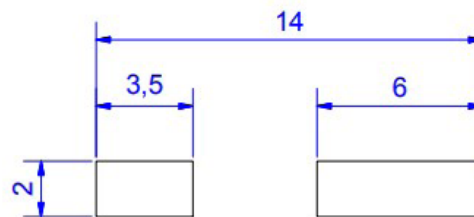
SMDflat 345

Montage / Installation / Ensamblaje / Assemblaggio



1

LEITERPLATTEN LÖTBILD *PCB Layout*



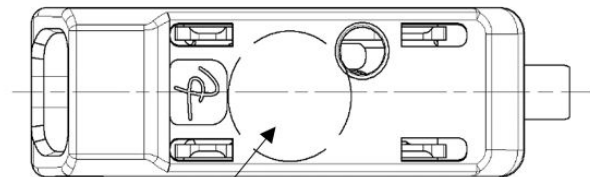
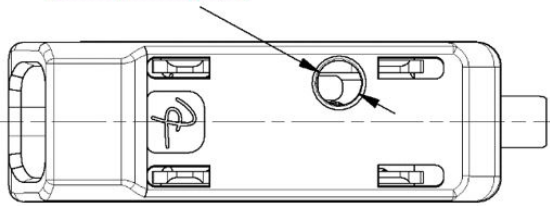
Empfohlener Lötpastenauftrag (Schablonenstärke): 0,12 mm
Schablonenkontur deckungsgleich mit dem Leiterplattenlayout.

*Recommended solder paste application (stencil thickness): 0.12 mm
The stencil outline is congruent with the PCB layout.*

2 BESTÜCKUNGS- UND LÖTINFORMATION

Pick & place and soldering information

Prüföffnung Kontakttiefe: Ø 1,1 mm
 Test opening contact depth: Ø 1.1 mm



Ansaugfläche: Ø 3,0 mm
 Pick & place area: Ø 3.0 mm

Angaben für den Reflow Lötprozess:

Lötprofil in Anlehnung an JEDEC J-STD-020/E Bild 5-1 für bleifreie Baugruppen bis zu einer Maximaltemperatur von 260°C.

Da der Lötprozess weiteren Einflussfaktoren wie z.B. Lötpaste, Fertigungsanlage, Leiterplattenparameter unterliegt, empfehlen wir die Durchführung von Verarbeitungstests und die Erstellung eines optimalen Lötprofils unter realen Fertigungsbedingungen. Im Zuge des Lötprozesses kann es zu geringfügigen Verfärbungen des Kunststoffmaterials kommen, welche keinen Einfluss auf die Funktion der Klemme haben.

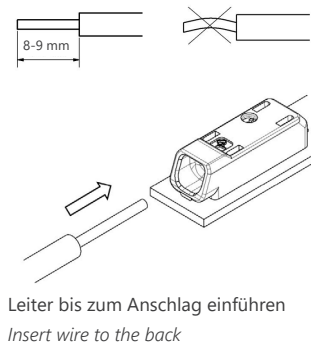
Specifications for the reflow soldering process:

Soldering profile following JEDEC J-STD-020/E Figure 5-1 for lead-free assemblies up to a maximum temperature of 260°C.

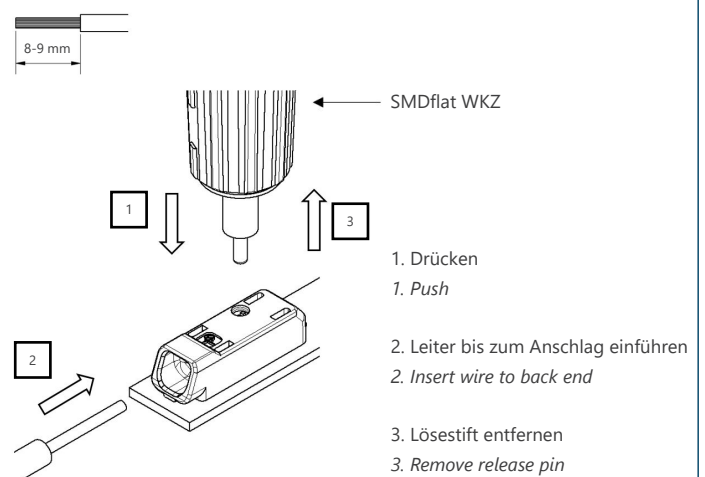
As the soldering process is subject to other influencing factors such as solder paste, production equipment, PCB parameters, we recommend carrying out processing tests and establishing an optimum soldering profile under real production conditions. The soldering process may cause slight discolorations of the plastic material, which have no influence on the function of the terminal.

3.1 LEITER EINFÜHREN *Wire insertion*

Starre Leiter 0,2 - 0,75 mm²
Rigid wires 0.2 - 0.75 mm²



Flexible Leiter 0,2 - 0,75 mm²
Flexible wires 0.2 - 0.75 mm²



3.2 LEITER LÖSEN *Wire release*

